



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102581495 B

(45) 授权公告日 2016.06.15

(21) 申请号 201210032833.7
 (22) 申请日 2012.02.14
 (73) 专利权人 中国科学院福建物质结构研究所
 地址 350002 福建省福州市杨桥西路 155 号
 (72) 发明人 黄见洪 吴鸿春 翁文 刘华刚
 葛燕 阮开明 邓晶 郑晖
 李锦辉 史斐 戴殊韬 林文雄
 (74) 专利代理机构 北京庆峰财智知识产权代理
 事务所(普通合伙) 11417
 代理人 谢蓉

CN 101983825 A, 2011.03.09,
 JP 2001-179470 A, 2001.07.03,
 EP 2216126 A2, 2010.08.11,

审查员 顾新云

(51) Int. Cl.
 B23K 26/70(2014.01)
 B23K 26/38(2014.01)
 G03B 15/03(2006.01)
 G03B 11/04(2006.01)

(56) 对比文件
 CN 101476939 A, 2009.07.08,
 CN 101559629 A, 2009.10.21,

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称
 一种应用于激光切割的双 CCD 成像系统

(57) 摘要

本发明公开一种应用于激光切割的双 CCD 成像系统,属光电子领域,可应用于激光切割,激光钻孔等激光加工方面。本发明包括三个成像镜组和两个 CCD 相机,上高倍成像镜组和低倍成像镜组在不同波长的照明光源下工作,并共用一个 CCD 相机。本发明的目的在于公开一种新的 CCD 成像系统,不仅能满足 LED 晶圆激光切割高精度的成像要求,同时降低了设备成本以及图像处理负担,对于提高设备厂家的经济效益具有重要的意义。

